



ADVANCED LINK TECHNOLOGY

반도체 분야에서 뛰어난 기술력과 경험을 바탕으로
끊임없이 미래에 도전합니다.

Investor Relations 2024

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사에이엘티(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.



CHAPTER
01



Earning Review

1. 2023년 4분기 실적
2. 연간 누적 실적
3. 사업부문 별 실적



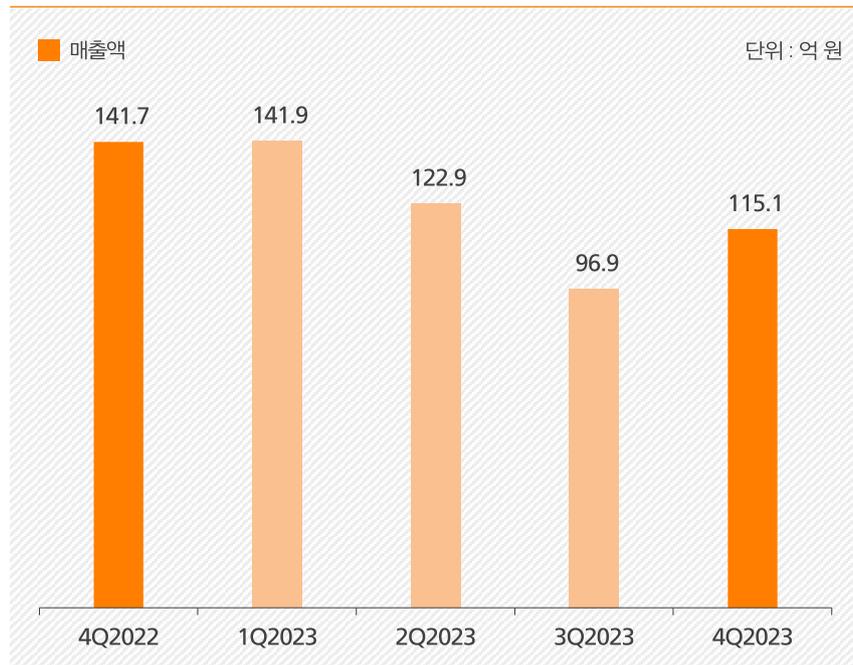
01

2023년 4분기 실적

전방 수요 감소로 22년 4Q 대비 매출액 18.7% 감소하였으나,
23년 3Q 대비 DDI, PMIC 등 물량 증가로 매출액 상승 전환

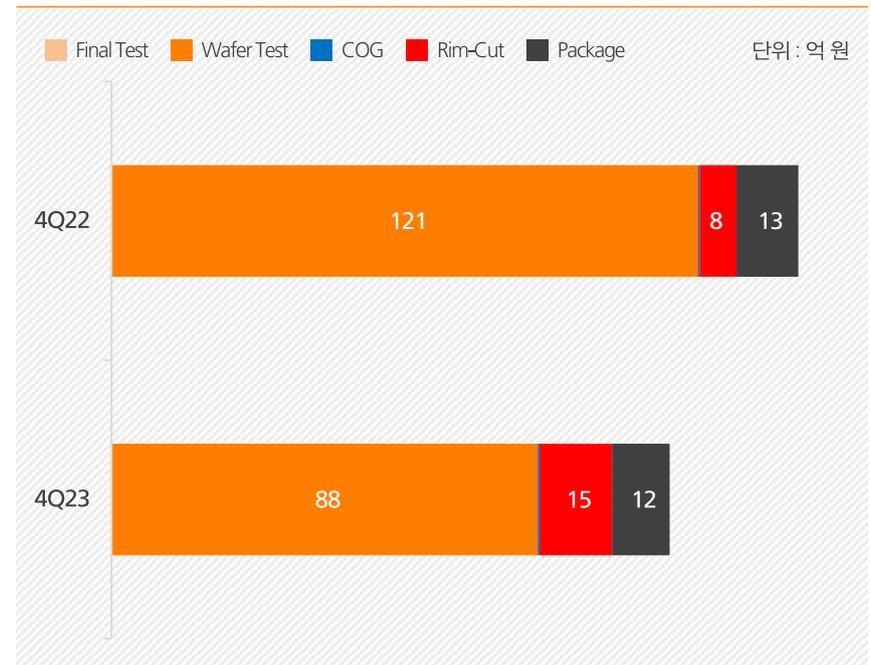
- » Wafer Test: 전년동기 대비 DDI(-19.8억, -13.9%), CIS(-21.2억, -17.2%), MCU(-5.4억, -11.7%) 매출 감소했으나, PMIC(+8.6억, +23.2%) 매출 증가 및 M/C(4.8억) 매출 신규 발생
- » Rim-Cut: 전년동기 대비 고객사 수주확대에 따라 +7.3억, +48.4%로 매출 대폭 신장

매출액



주: K-IFRS 연결 기준

전년동기 대비 사업부별 매출액





2023년 4분기 실적



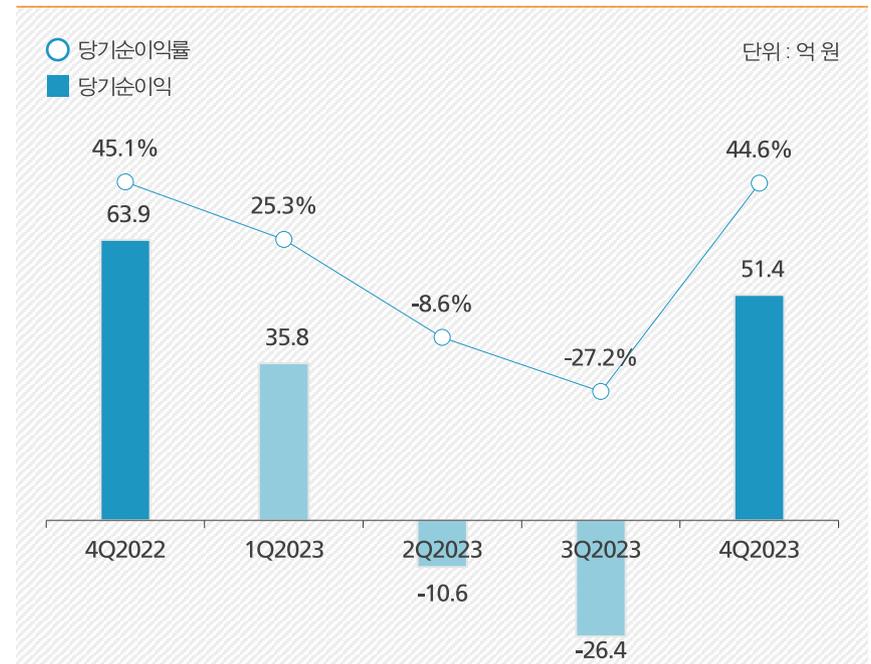
설비 도입에 따른 영업비용 증가했으나, 일시적 비용 효과 해소로 전분기 대비 흑자전환

- » 영업비용 증가: 전년동기 대비 M/C 등 설비 증설에 따른 감가상각비(+8.9억, +23.2%) 및 전력비 증가
- » 매출액 감소 및 설비 도입에 따른 비용, 상장 관련 CB 평가손실로 연중 적자전환했으나, 일시효과 해소로 4Q 흑자전환

영업이익(률)



당기순이익(률)



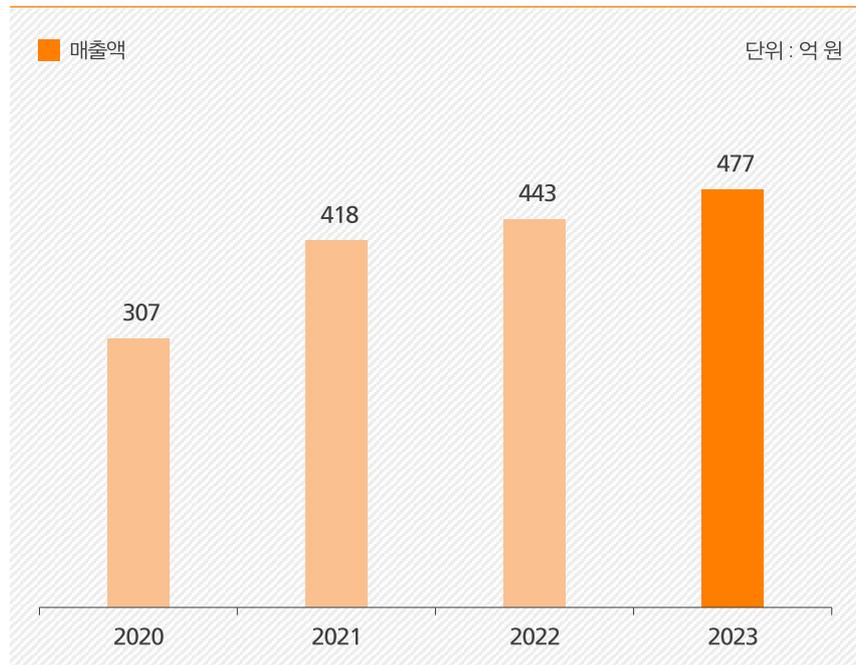
02

연간 누적 실적

매출액은 Wafer Test와 Rim-Cut 매출 상승으로 전년 대비 7.6% 증가한 477억원 기록

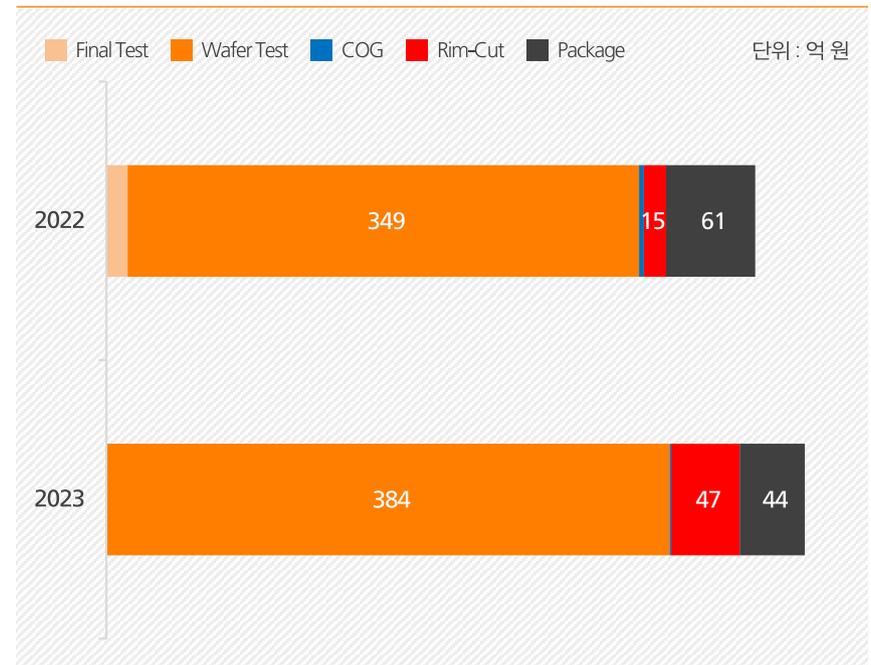
- » Wafer Test: 상반기 주요고객사 호조로 DDI 매출 큰 폭 증가(+105.4억, +73.9%), M/C 매출 9월부터 일부 발생(6.5억원) CIS(-59.8억, -48.7%)는 고객사 제품 런칭 지연 등으로 매출 감소
- » Rim-Cut: 고객사 수주 확대에 따라 +31.7억, +209.3%

매출액



주: K-IFRS 연결 기준

전년 대비 사업부별 매출액



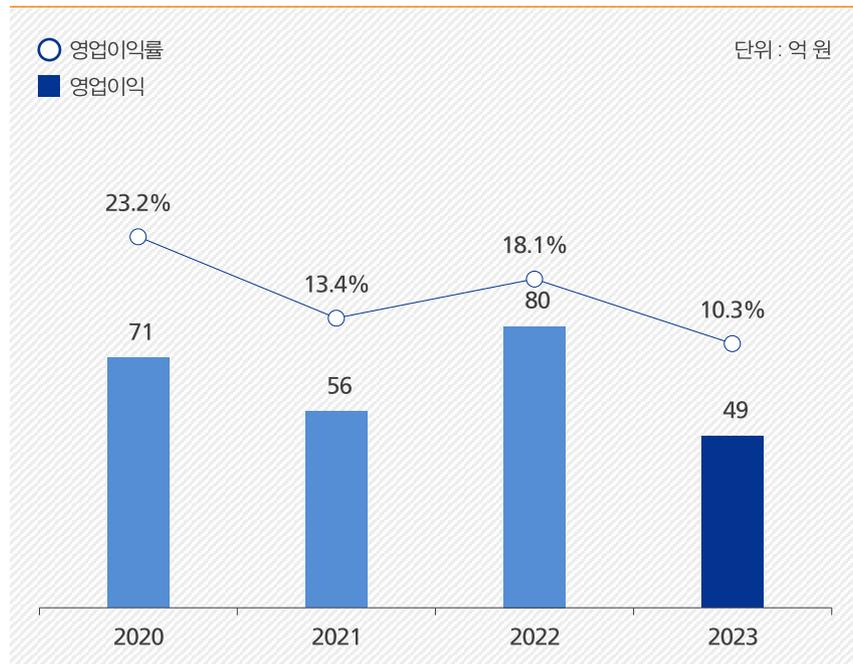
02

연간 누적 실적

설비 도입에 따른 영업비용 증가, 영업외 일시적 손실 반영에 따른 당기순이익 하락

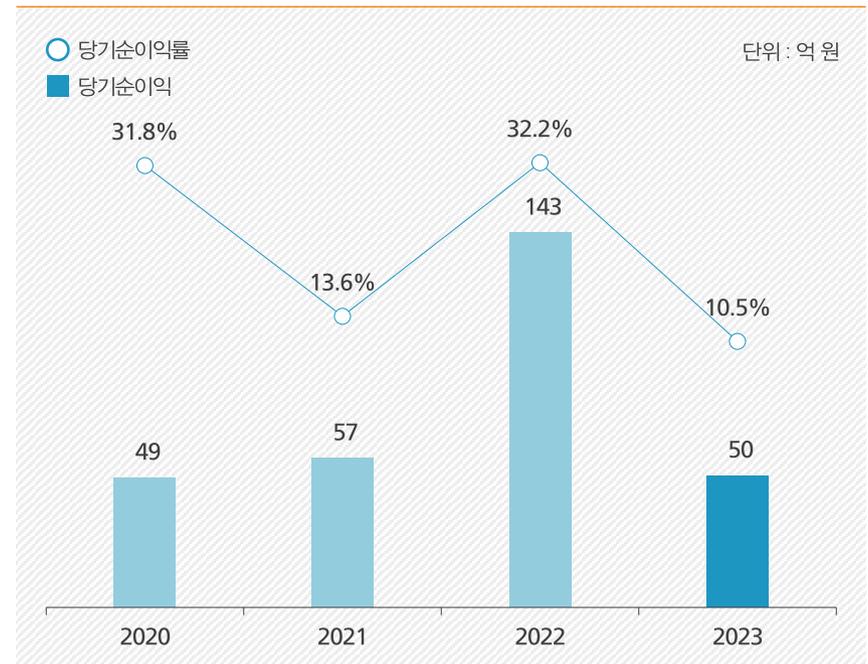
- » 영업비용 증가: M/C 등 설비 증설에 따른 감가상각비(+41.2억, +31.7%) 및 전력비 증가. 9월부터 M/C 일부 매출 발생
- » 조달비용 증가: 금리 인상에 따른 이자비용(+16.3억, +73.3%) 증가.
- » 일시적 영업외 비용 발생: 상장에 따른 CB평가손실(36.8억) 및 외화에 대한 환율변동으로 인한 감소 효과(22.5억) 발생

영업이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

당기순이익(률)

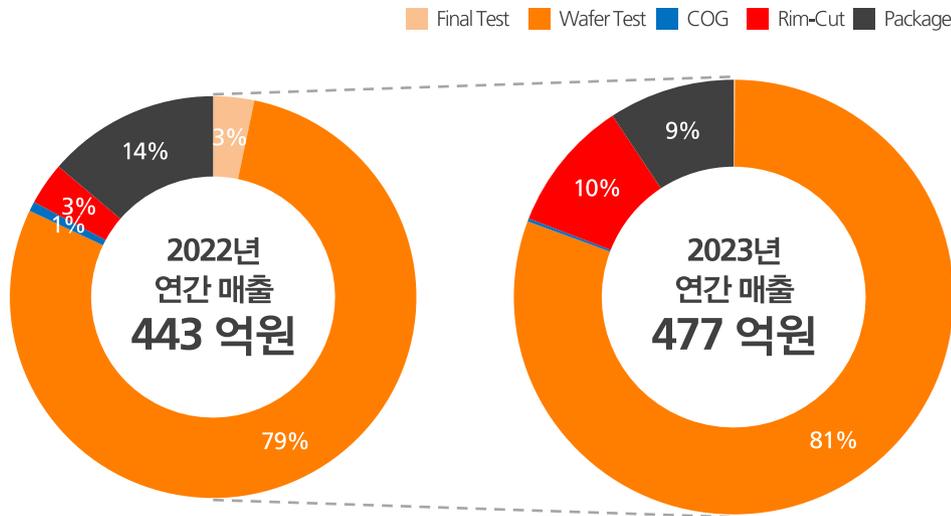


사업부문 별 실적

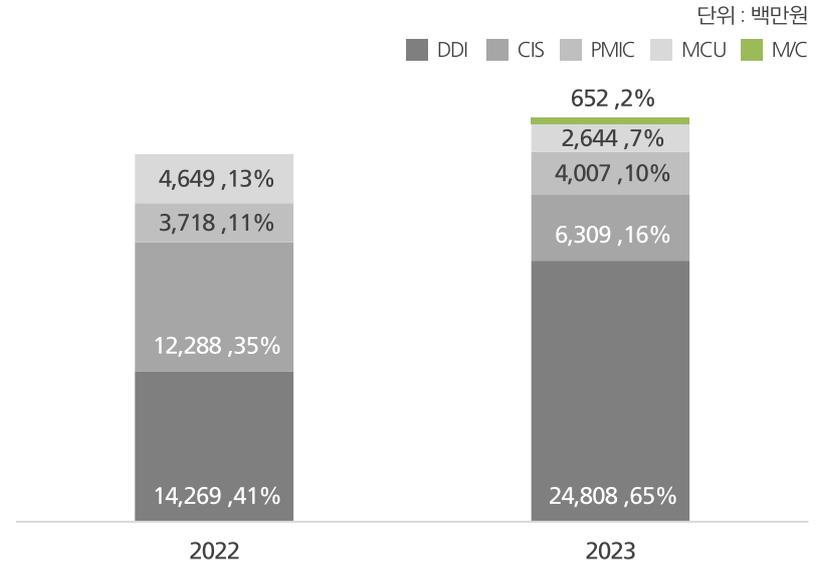
주력사업인 Wafer Test 매출 증가, 신규사업 Rim-Cut 매출이 큰 폭으로 성장



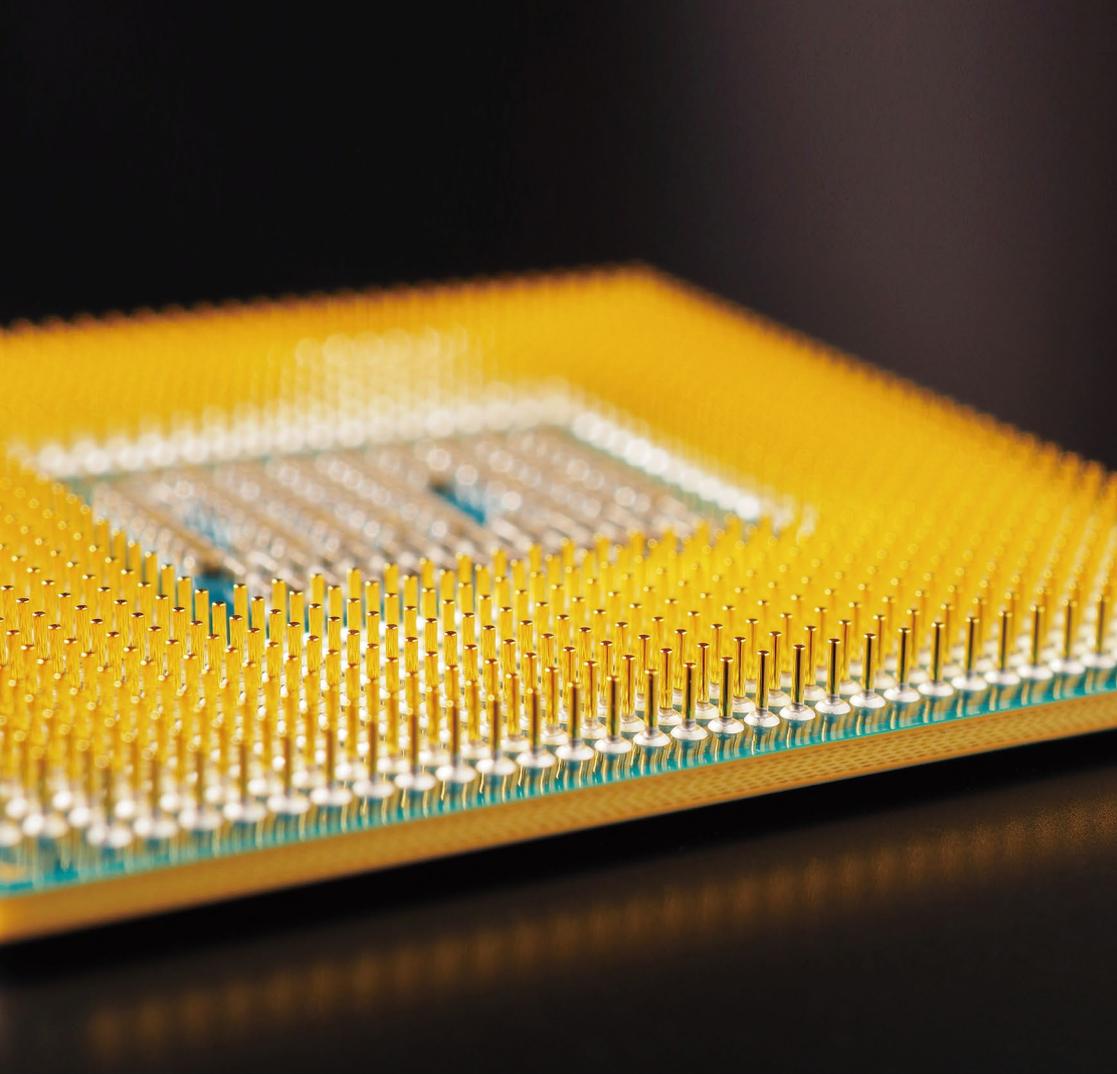
전체 사업부 매출



Wafer Test 세부매출



	Final Test	Wafer Test	COG	Rim-Cut	Package	합계
2022	1,448	34,923	342	1,514	6,091	44,319
2023	47	38,419	108	4,683	4,431	47,688
YoY	-96.7%	+10.0%	-68.5%	+209.3%	-27.3%	+7.6%



CHAPTER
02



Company Overview

1. 사업영역
2. ALT 비메모리 반도체 공정 영역
3. 다양한 고객사 확보



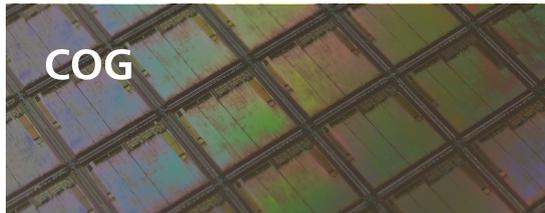
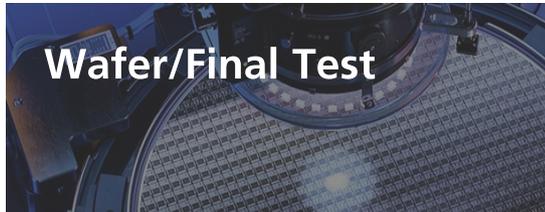
01

사업영역

OSAT(Wafer test + Packaging) 사업 기반 다양한 비메모리 반도체 후공정 업무 수행

매출분야

ALT 주요 비메모리 반도체



DDI (Display Driver IC)

각종 LCD Panel, LED, OLED 등을 구동 시키는 반도체 소자

적용 산업

스마트폰 TV PC 스마트워치

CIS (CMOS Image Sensor)

빛에너지를 전기적인 신호로 변환하는 집적회로가 내장된 이미지 센서

적용 산업

스마트폰 CCTV 자동차 로봇

PM-IC (IGBT 등)

전자기에 필요한 전력 공급 및 효율적 관리

적용 산업

스마트폰 노트북 전기차 IoT

MCU / SoC

전자기에 채택되는 통합 칩(SoC) 단순 동작부터 AI 등 다양한 특성을 제어

적용 산업

스마트폰 IoT 자율주행 스마트 팩토리

M/C (Memory Controller)

메모리를 관리, 제어하고 효율적인 데이터 처리를 지원하는 칩

적용 산업

스마트폰 PC 서버 통신장비

AP (Application Processor)

모바일 기기와 임베디드 시스템의 다양한 작업을 처리하는 통합 프로세서

적용 산업

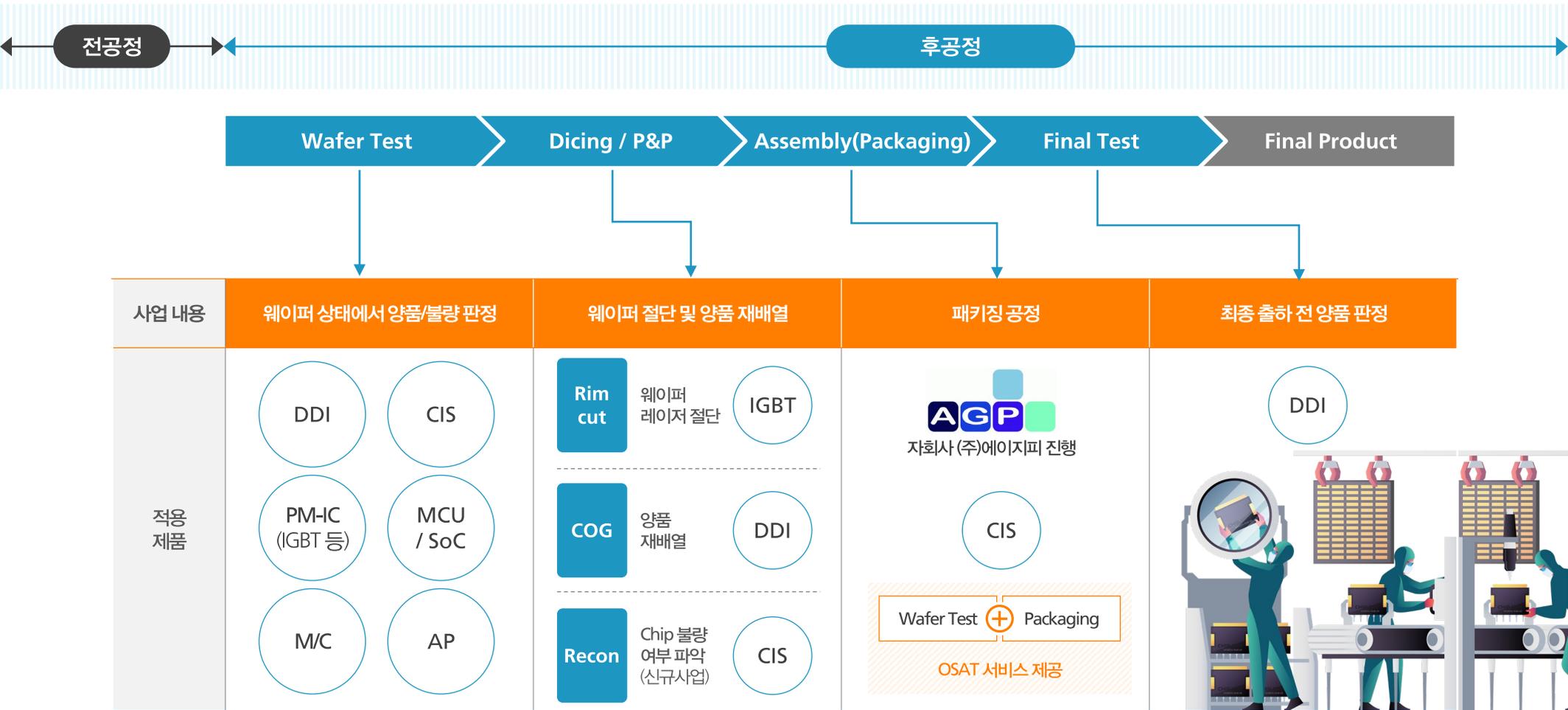
스마트폰 스마트워치 자동차 IoT

02

ALT 비메모리 반도체 공정 영역

비메모리 반도체 후공정 토탈 솔루션 제공

■ ALT 사업 영역

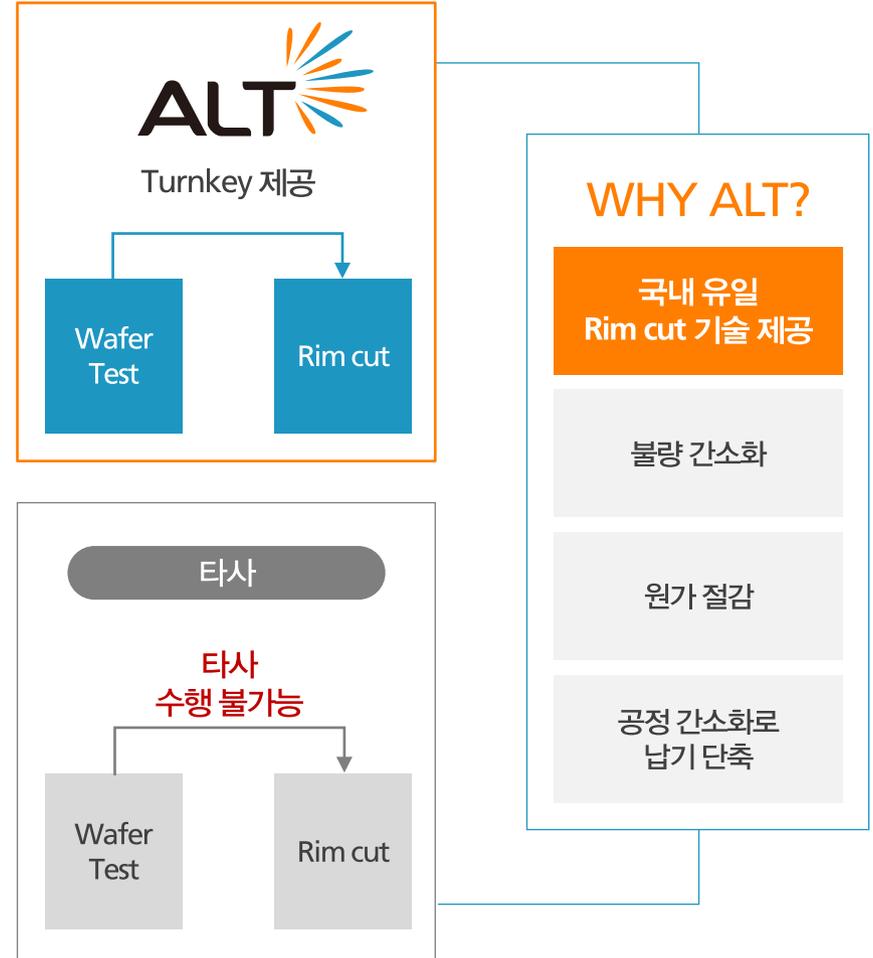
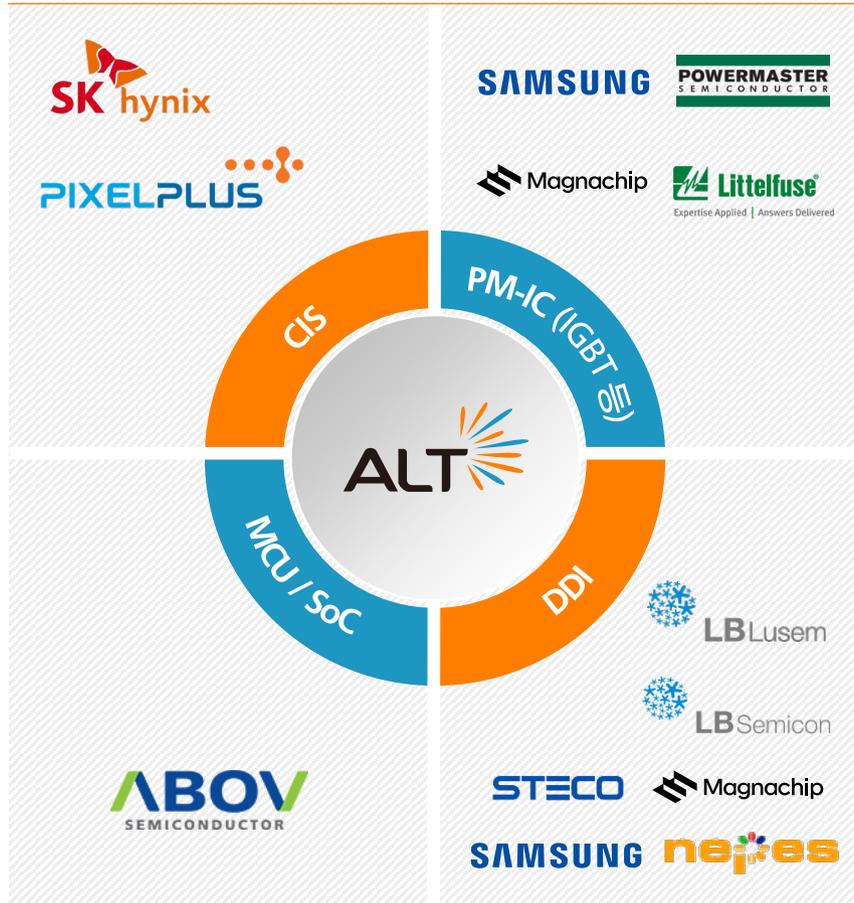


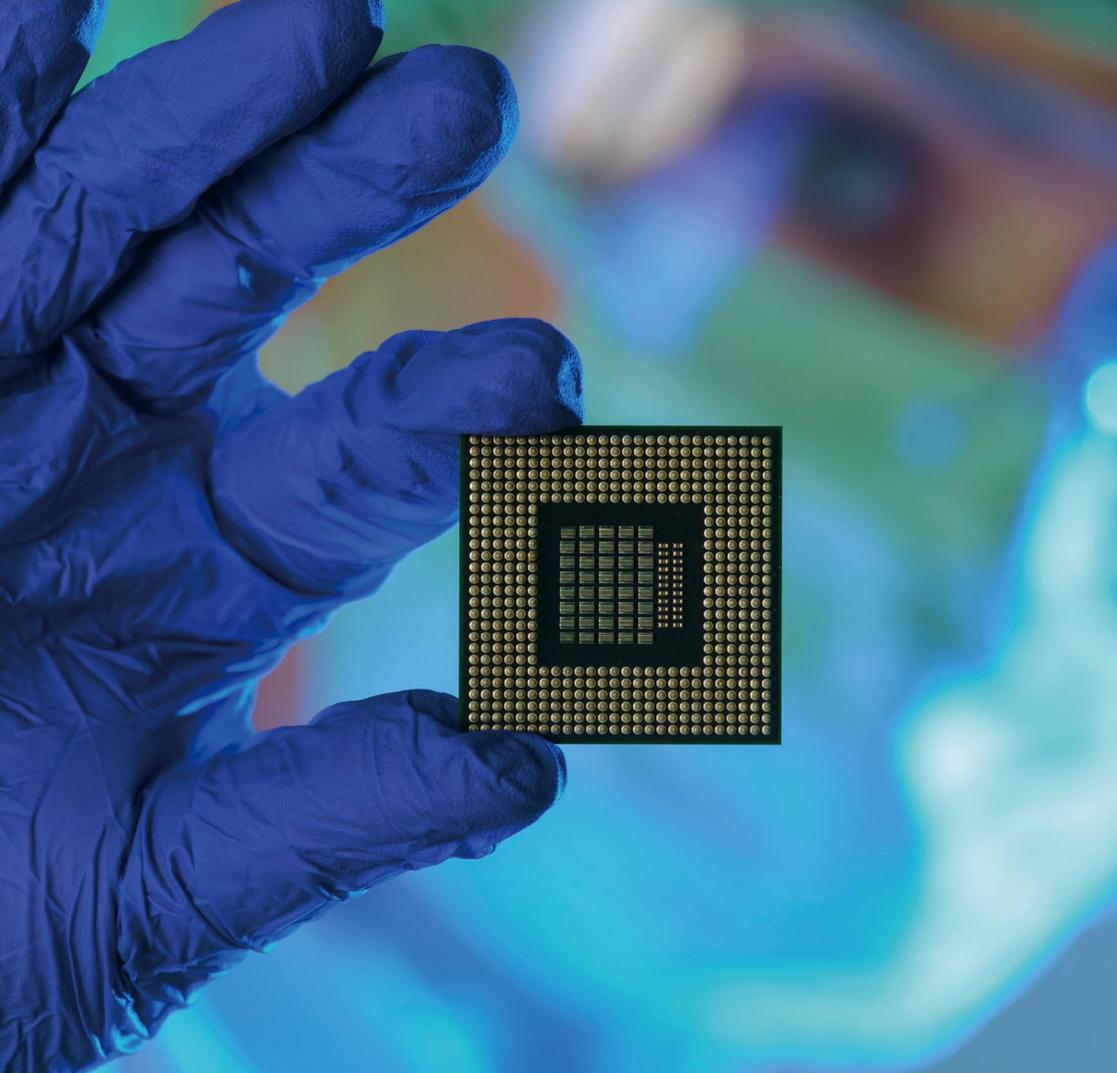
다양한 고객사 확보

ALT만의 차별화된 기술 제공으로 다양한 고객사 확보



ALT 사업영역별 다양한 고객사



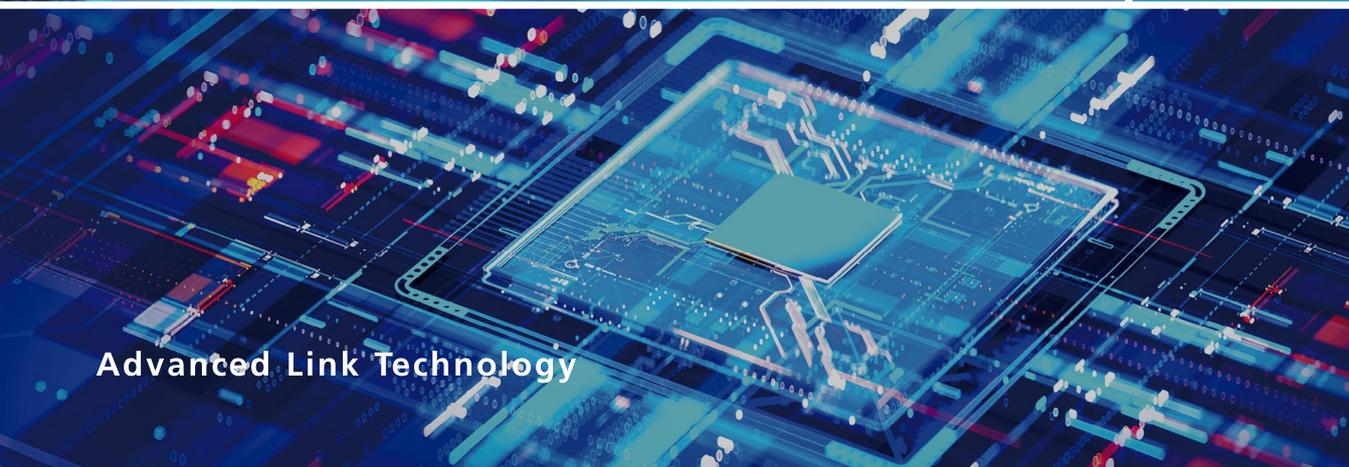


CHAPTER
03



Item Solution

1. Probe Test
2. Ring(Rim) Cut
3. Recon(CIS 등)
4. Package
5. 신규 사업영역 확장



01

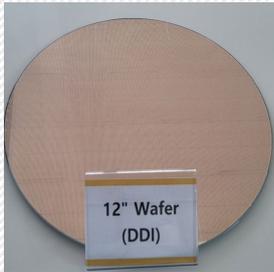
Probe Test

반도체 수율 향상을 위한 필수공정



Probe Test Process

Wafer 상태의 Chip의 양품 선별공정으로, Chip의 불량 식별 및 설계상의 문제점을 발견해 개선하는 공정으로, 반도체 수율 향상을 위해 반드시 필요한 솔루션



DDI Wafer

웨이퍼 투입

Prober에 투입, 자동검사

적용제품
DDI, CIS, PM-IC, M/C, AP,
MCU/SoC 등



TEST LINE



TESTER+PROBER

Wafer Test

Chip의 양품/불량 여부 및 고유값 측정



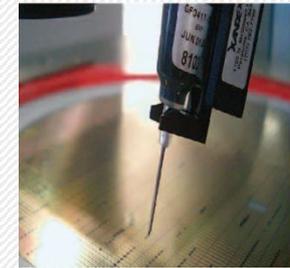
PROBER



AVI

AVI 검사

외관상 이물, 기타 특이사항
검사



INKING

잉킹

불량 칩에 잉크로 표시

02

Ring(Rim) Cut

PM-IC(IGBT 등) 웨이퍼 테스트 및 국내 유일 Rim Cut 기술을 Turnkey로 제공



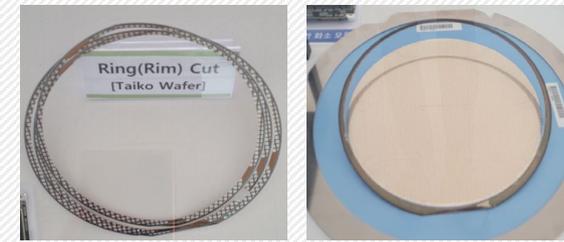
Ring(Rim) Cut Solution

국내 최초로 Laser Cut 방식을 도입, Kerfwidth 최소화로 Net Die 손실을 줄이는 Taiko Wafer 테두리 절단 분리 솔루션



Full Auto System

5개 공정을 1개 공정으로 단축, Handling 과정에서 발생하는 Wafer Damage 발생 근본적으로 해소



Taiko Wafer

Wafer 안쪽을 얇게(70 μ m) 갈아내고, 테두리는 두껍게 남겨놓는 가공공법

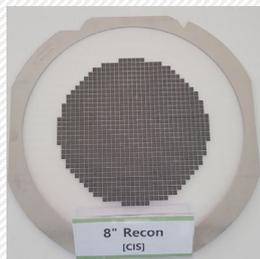
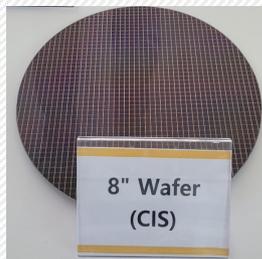
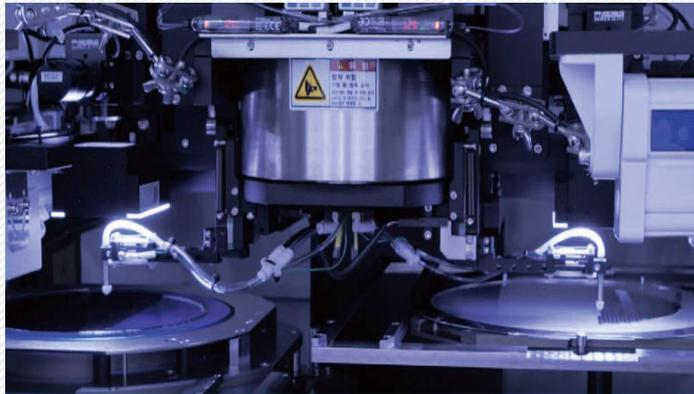


Blade Saw
절단폭이 넓어 Net Die 수량 감소 파편에 의한 Chip 손상으로 수율 감소
Laser Cut
절단폭 최소화, Net Die 최대화 열손상 및 파편에 의한 Chip 손실 예방



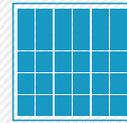
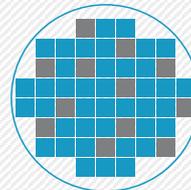
Recon: Wafer Reconstruction

Sawing 후 양품 Chip을 Pick Up하여 고객 요청에 맞추어 Wafer 형태로 테이프에 재배치하는 솔루션



COG

DDI칩 Sawing 후 고객이 원하는 양품칩만을 Tray에 재배열



■ 양품 chip
■ 불량 chip

Wafer 사이즈별 재배열

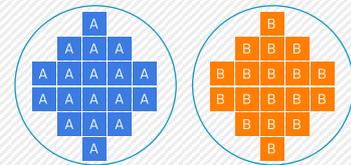
8인치, 12인치 웨이퍼,
*경박단소 필요제품 재배열 가능

고품질 생산 시스템 구축

Turnkey 서비스 제공
생산 표준화 MES 시스템 구축

Recon

Wafer Test 후 선별된 양품 Chip 성능별 구분 및 재배열



성능별 Chip 재배열

빠른 후속 공정 가능

One Stop 솔루션 제공

Test - Back Grinding
- Sawing - Recon

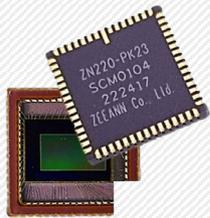
04

Package

CLCC(고신뢰성 세라믹 패키지), PLCC(플라스틱 패키지) 조립 및 테스트 공정



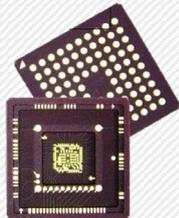
Automotive & Military Sensor



CLCC
일반용



A_BGA
전장 및 방산용



MCP
멀티칩

CIS

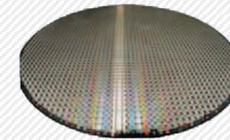
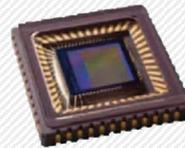
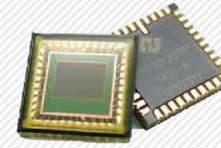


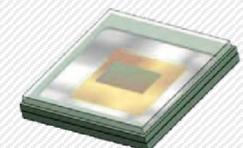
IMAGE SENSOR WAFER



CLCC
세라믹 바디



PLCC
플라스틱 바디



BGA
볼 리드

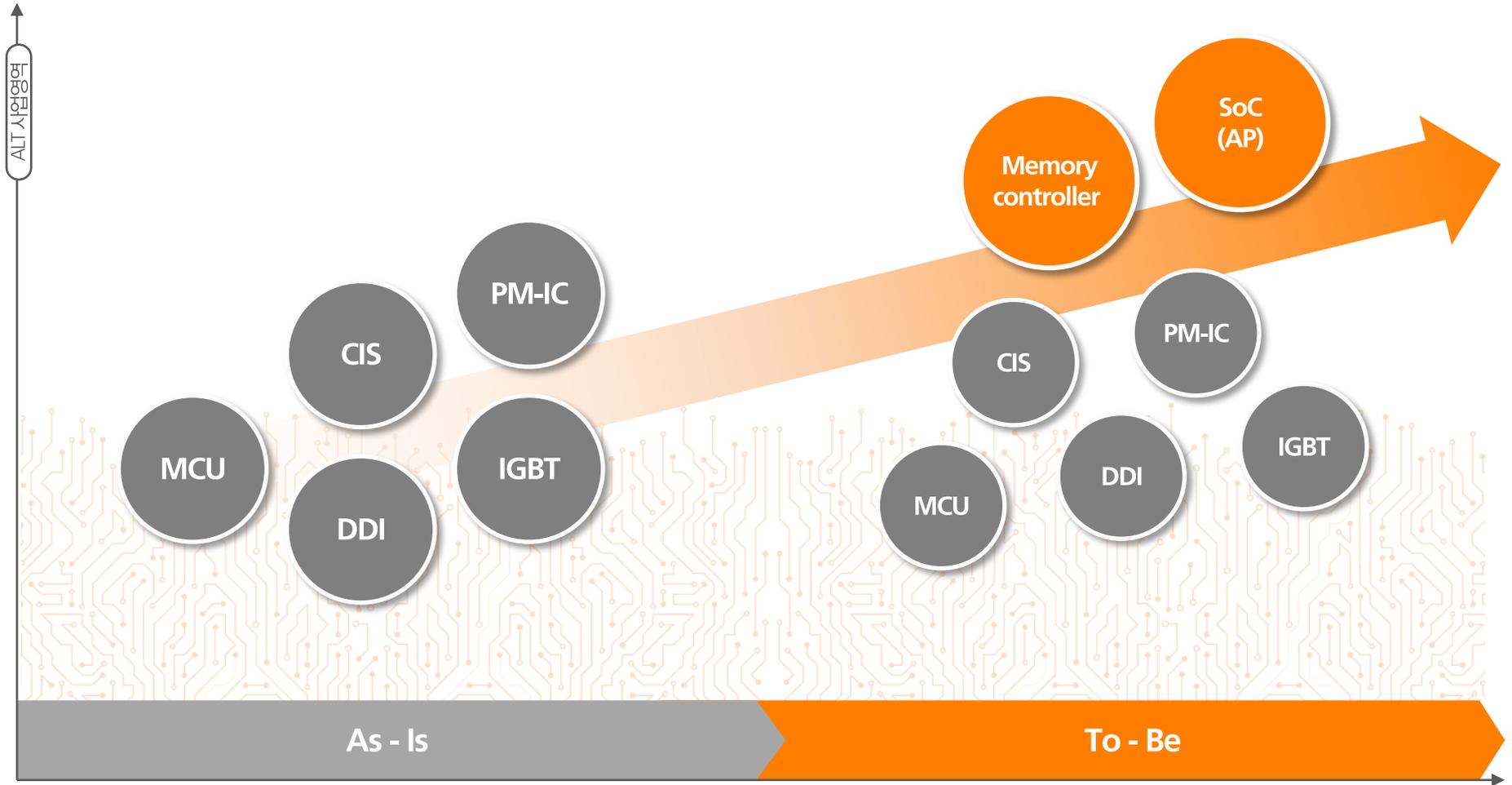
Appilcation

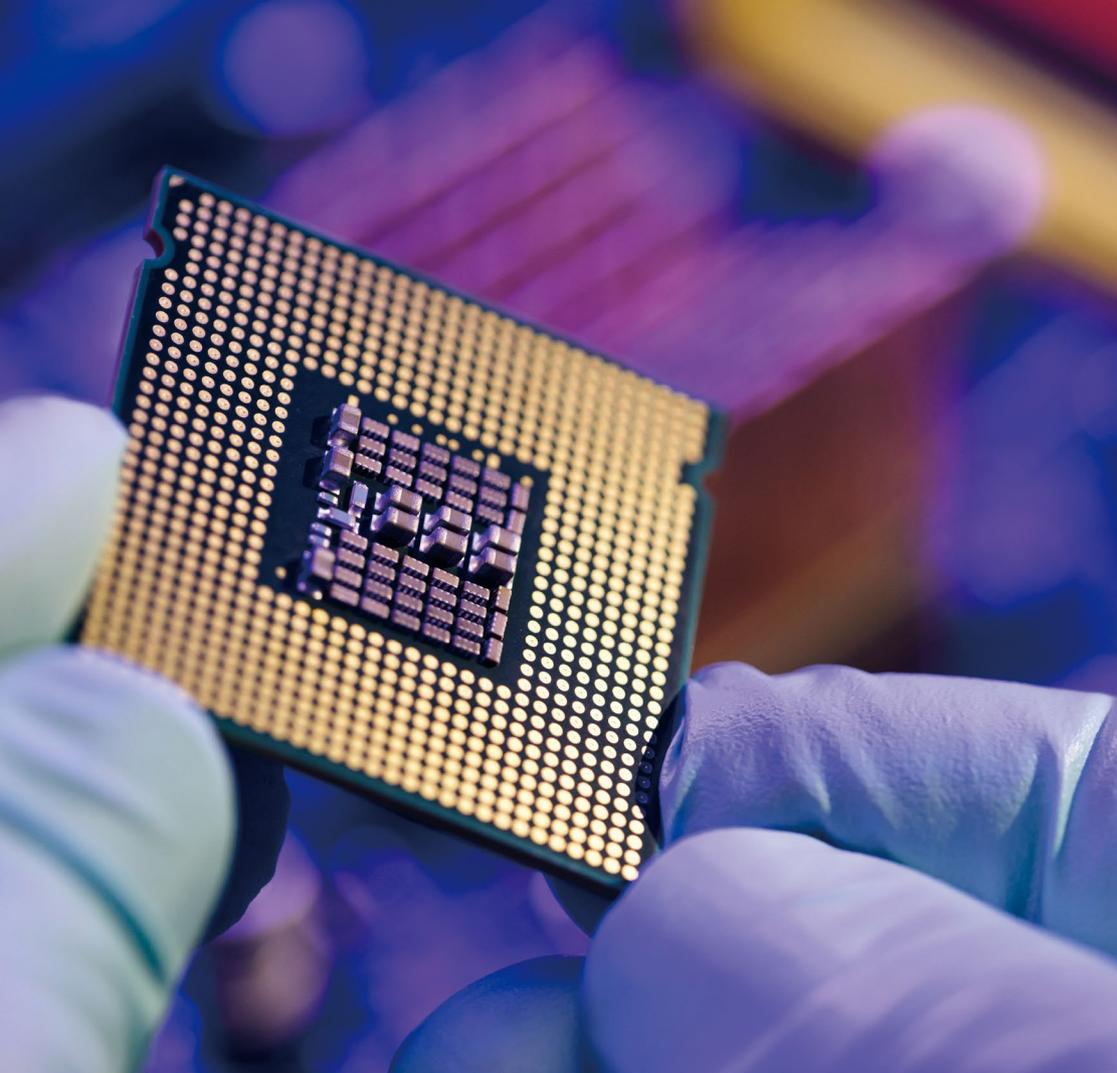


05

신규 사업영역 확장

Memory controller, AP 등 신규 테스트 사업 대상 품목 확대





CHAPTER
04



Appendix

1. 회사 개요
2. 회사 연혁
3. 요약 재무제표



01

회사 개요

20년 업력의 비메모리 반도체 후공정 전문 기업

기업개요

회사명	(주) 에이엘티
대표이사	이덕형
설립일	2003년 7월 23일
자본금	44.8억 원
종업원수	181명
본점소재지	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
홈페이지	www.alt-s.kr

대표이사



이덕형 CEO

- 서울대학교 물리학과 졸업, 이학박사
- 삼성전자(주) 근무 27년
- 삼성전자(주) 전무이사 역임
- LSI 공정개발 및 생산 총괄
- 삼성종합기술원 이미지 소자 랩장/ 전무이사 역임
- 스테코(주) 근무 3년
- 스테코(주) 대표이사 역임
- 現 ALT 대표이사

지배구조 및 사업영역



80.05%



비메모리 후공정 테스트 사업 영위



CIS 패키징 사업 영위



02

회사 연혁

비메모리 반도체 포트폴리오가 다변화된 OSAT 전문기업으로 성장 중

사업기반 구축 (2003~2013)

- 2003**
 - 07월 에이엘티세미콘(주) 설립 (자본금22.5억)
 - 08월 2003년 (주)하이닉스 MOU체결
- 2004**
 - 03월 공장준공 (오창과학산업단지)
 - 06월 기업부설연구소 인가
- 2005**
 - 04월 CIS(CMOS Image Sensor) 양산시작
- 2006**
 - 10월 삼성전자(주) 물품공급계약 체결
 - 11월 (주)루셈 물품공급계약 체결
- 2007**
 - 12월 SK하이닉스(주) CIS 양산 시작
- 2008**
 - 07월 건물 2,890평 증축 준공
- 2009**
 - 05월 Magna Chip 외 P/T 양산
- 2013**
 - 07월 회사명 변경
(에이엘티세미콘(주) → (주)에이엘티)

사업 고도화 및 성장기 (2014~2020)

- 2015**
 - 01월 스테코 DDI 양산 시작
 - 03월 제 49회 납세자의 날
성실납세자 대통령 표창
 - 09월 CIS T2000 설비 투자 및 양산 시작
- 2016**
 - 03월 DDI 12인치 Wafer P/T 양산 시작
- 2018**
 - 11월 삼성 PM-IC(Wafer Test) 양산 시작
- 2019**
 - 10월 제16회 충청북도 중소기업대상
수출대상
- 2020**
 - 02월 SK하이닉스 CIS 300mm(64para) 선정
 - 08월 중소벤처기업공단 K-예비유니콘
유망기업
 - 08월 신규 Biz COG 양산 시작

도약기 (2021~)

- 2021**
 - 03월 ISO 14001:2015 인증 획득
 - 04월 IATF 16949:2016 인증 획득
- 2022**
 - 03월 삼성 DDI, EDS P검 Biz 시작
 - 09월 삼성 Memory controller P검
설비투자
- 2023**
 - 07월 코스닥시장 상장
 - 11월 ESG 경영인증서 획득